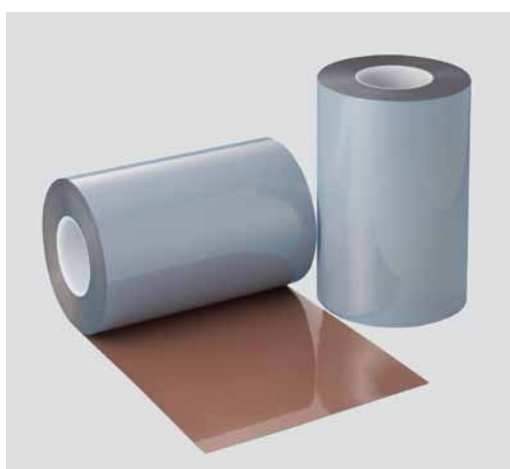


高段差対応型FPC用 電磁波シールドフィルム

SF-PC6000-U1



UL登録内容

UL94 VTM-0 (Kapton50Hとの組み合わせ)
※Kapton®は米国デュポン社の登録商標です

環境適合性

環境対応	SF-PC6000-U1
UL94 燃焼クラス	VTM-0
ハロゲンフリー	適合
RoHS指令	適合
鉛フリーハンダリフロー対応	適合

SF-PC6000-U1は基板段差(フレックスリジッド基板や多層FPC)の埋め込み性を向上させた電磁波シールドフィルムです。近年、フレックスリジッド基板はフレックス部とリジッド部の段差が150 μ m以上の高段差タイプが増えつつあります。

SF-PC5500シリーズもこのような段差に対応可能でしたが、加工機の精度や制御範囲のバラツキにも影響を受けないグレードをSF-PC6000-U1として製品化しました。SF-PC5500シリーズの諸特性を維持しながら300 μ mを超える段差にも対応可能な高段差対応型のシールドフィルムです。

特徴

▶ 高段差埋め込みに対応

フレックスリジッド基板や多層FPCの高段差(300 μ m以上)埋め込み性を格段に向上

▶ 優れた耐OSP性及び耐薬液性を実現

シールドフィルム貼り合せ基板でのOSP処理、薬液処理にも対応

▶ シールド材料に銀-銅複合金属を使用

純銀タイプのシールド材と比較し、コストパフォーマンスに優れます

▶ シールド特性・屈曲特性は従来品と同等以上

SF-PC6000-U1の構成

